

■ 財務概況

財務概況

損益状況

当期の事業環境

2016年3月期の世界経済は、中国をはじめとする新興国の一部において経済成長に鈍化が見られたものの、全体としては緩やかな回復を示しました。エレクトロニクス産業においては、モバイル端末の高機能化やクラウドサービスの発展により、端末一台当たりのメモリ搭載容量やデータセンター向けCPUとメモリの需要が伸長しました。IoT (Internet of Things) 時代の幕開けと3次元構造などの新しいメモリや先端ロジック半導体が牽引役となり、半導体メーカーによる設備投資が実施され、当社が参画する半導体製造装置市場は堅調に推移しました。薄膜トランジスタ (TFT) アレイ工程向けフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置市場においては、大型液晶パネル向け設備投資は減少となりましたが、中小型パネル向けが大きく増加し、全体としては伸長しました。

売上の状況

当社の注力製品の顧客展開が順調に進捗したことに加え、パーツ販売と旧世代技術の需要増に伴った中古装置販売が伸び、当期の売上高は前期比8.3%増加の6,639億円となりました。

国内向け売上高は前期比28.2%増加の1,218億円、海外向け売上高は前期比4.6%増加の5,421億円となり、売上高全体に占める海外向け売上高の比率は前期の84.5%から81.7%に2.8ポイント低下しました。

なお、当期の受注高は前期比2.8%増加の6,793億円となりました。また、当期末の受注残高は5.2%増加の3,111億円となりました。半導体製造装置およびFPD製造装置

の受注高、受注残高については、P18に記載されているセグメント別の状況をご参照ください。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比7.1%増加の3,967億円となりましたが、売上高が8.3%伸長したため、売上原価率は前期から0.6ポイント低下の59.8%となりました。売上総利益は前期比10.1%増加の2,672億円となり、売上総利益率は前期比0.6ポイント上昇の過去最高40.2%となりました。

販売費及び一般管理費 (販管費) は、主にアプライド マテリアルズとの経営統合契約の解約に伴う統合関連費用の減少により、前期比2.7%減少の1,504億円となりました。売上高販管費比率は、前期の25.2%から22.6%に低下しました。

これらの結果、営業利益は前期比32.5%増加の1,168億円、営業利益率は前期の14.4%から17.6%へと上昇しました。

研究開発費

研究開発費は、前期比6.9%増加の763億円となりました。研究開発費の主な増加要因は、半導体製造装置の注力分野であるエッチング装置、成膜装置、洗浄装置に研究開発費を積み増したことにによるものです。対売上高比率については、前期比0.1ポイント低下し11.5%となりました。

当社は、高い技術力が成長の源泉であるとの考えのもと、中期経営計画の達成に向けた強いNext Generation Productを創出するべく、今後市場成長が見込まれる分野を中心に投資を行いました。半導体製造装置分野では、さらなる微細化に必要なマルチパターニング、3次元構造のNANDフラッシュメモリや新材料に対応するエッチン

グ技術、成膜技術、洗浄技術などのキーテクノロジーの開発に注力しました。

これまでの研究開発の成果として、先端パッケージング技術にも対応したコータ / デベロッパや、次世代微細化に対応した枚葉成膜装置などの新製品をリリースしました。また、STT-MRAM*の製造などに用いられるスパッタリング装置EXIM™が複数顧客の開発ラインに導入されました。

FPD製造装置分野では、中小型の高精細パネル向けに、新しいエッチング装置を市場投入しました。

* STT-MRAM : Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory (低消費電力が期待できる磁気メモリ)

その他収益・費用および親会社株主に帰属する当期純利益

当期は、主な収益として、旧テクノロジーセンターつくばの土地、建物などの売却益10億円、為替差益9億円、受取利息及び受取配当金9億円を計上しました。また、主な費用としては、TEL FSI, Inc.の事業計画を見直したことによるのれんなどの減損損失97億円、事業再編損失22億円などを計上しました。これにより、その他収益・費用は純額で103億円の費用 (前期は13億円の費用) となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は前期比22.6%増加の1,065億円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比8.4%増加の779億円となりました。一株当たり当期純利益は、自己株式の取得と消却 (発行済株式総数の8.53%)

の効果もあり、当期純利益の増加率を上回る前期比15.0%増加の461.10円となりました。

包括利益

当期は、当期純利益が前期比60億円増加の779億円を計上した一方で、日本のマイナス金利政策の影響による退職給付会計における割引率の減少により、退職給付に係る調整累計額として92億円の損失、円高影響による為替換算調整勘定として57億円の損失、その他有価証券評価差額金16億円の損失などを計上した結果、包括利益は前期比24.1%減少の610億円となりました。

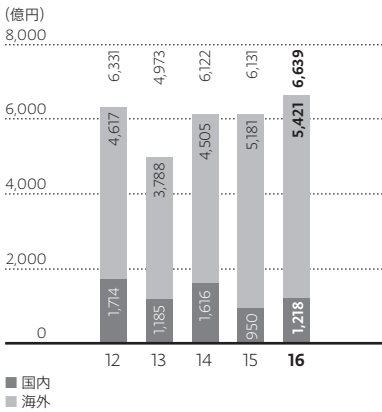
配当政策、当期配当金および自己株式取得

当社は、業績連動型の配当を株主還元の基本方針としています。グローバルレベルの収益力実現を目指す中、配当もそれに応じて強化すべきと考え、配当性向を2016年3月期より35%から50%に引き上げました。さらに安定配当の観点も考慮し、一株当たり通期150円という下限も設定しました*。

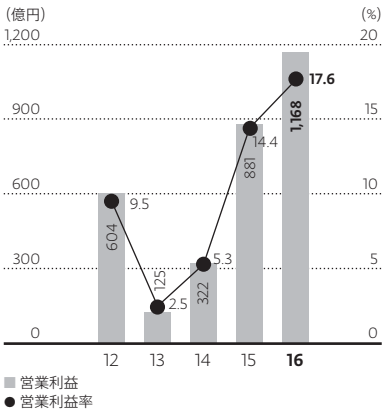
これにより当期の年間配当金は、堅調な業績も反映し、過去最高となる一株当たり237円 (配当性向51.4%) としました。加えて、自己株式の取得と消却 (発行済株式総数の8.53%) を実施しました。

* 2期連続で当期利益を生まなかった場合は下限設定の見直しを検討します

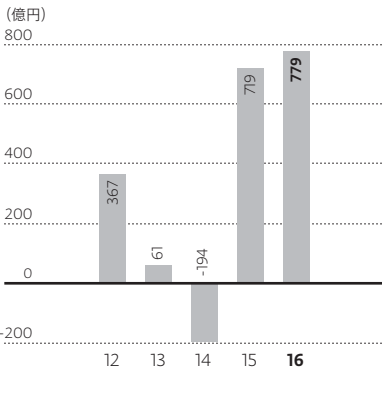
■ 国内および海外売上高



■ 営業利益および営業利益率



■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失)



損益状況	百万円				
	2012	2013	2014	2015	2016
売上高	¥633,091	¥497,300	¥612,170	¥613,125	¥663,949
売上総利益	211,445	158,755	201,892	242,774	267,210
売上総利益率	33.4%	31.9%	33.0%	39.6%	40.2%
販売費及び一般管理費	151,002	146,206	169,687	154,661	150,421
営業利益	60,443	12,549	32,205	88,113	116,789
営業利益率	9.5%	2.5%	5.3%	14.4%	17.6%
税金等調整前当期純利益 (損失)	60,602	17,767	(11,756)	86,828	106,467
親会社株主に帰属する当期純利益 (損失)	36,726	6,076	(19,409)	71,888	77,892

■ 財務概況

財務概況

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

スマートフォンの高機能化やデータセンター向けサーバー需要を背景に、DRAMとNANDフラッシュメモリの需要は底堅く、特にDRAMメーカーによる先端ノードへの設備投資が伸長しました。一方、電子機器需要が想定ほど伸びず、ロジックメーカーとファウンドリの設備投資は抑制され、2015年の半導体製造装置市場は、前年と同水準となりました。

このような状況のもと、当社が注力分野として位置づけている成膜装置と洗浄装置の売上高が前期より増加しました。成膜装置はバッチ、セミバッチ装置ともにALD*工程でのポジションが向上し、洗浄装置はロジックとメモリにおいて注力工程での採用が進みました。エッチング装置については、先端パターニングや3D NANDのHARC工程**での採用が拡大した一方で、ロジックとファウンドリ向けの投資割合が減少した影響を受け、売上高は前期よりわずかながら減少となりました。

パーツ・中古装置の販売や改造・保守サービスなどを手がけるフィールドソリューション事業については、高い技術力を有する装置メーカー認定の中古装置やパーツの需要が高まり、売上高は前期より約8%増加しました。

これにより、当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比6.4%増加の6,130億円となりました。セグメント利益については、TEL FSI, Inc.の事業計画見直しに伴う

のれんなどの減損損失の計上により、前期比9.4%減少の1,232億円、セグメント利益率は前期の23.6%から20.1%となりました。

当期の受注高は前期比0.1%減少の6,263億円、期末の受注残高は前期比5.1%増加の2,737億円となりました。

当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

* ALD (Atomic Layer Deposition) : 原子レベルで一層ずつ膜を堆積させる成膜手法
**HARC (High Aspect Ratio Contact) 工程 : 高度な加工技術を要する深穴形成工程

■ FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

FPD製造装置市場は、大型液晶パネル向けの設備投資は減少しましたが、モバイル端末用中小型液晶パネル向けの投資が大きく増加し、全体としては伸長しました。このような状況のもと、大型液晶パネル向けで優位性をもつ当社のICP(誘導結合プラズマ)エッチング装置のシェア向上も寄与し、販売が引き続き好調でした。また、大型テレビ用有機ELパネル向けインクジェット描画装置の初号機の売上也計上しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比36.6%増加の447億円となりました。セグメント利益は前期13億円の損失から47億円の黒字となり、セグメント利益率は10.6%となりました。

当期の受注高は前期比43.1%増加の505億円、期末の受注残高は前期比18.4%増加の374億円となりました。

当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

■ その他

事業撤退を発表した太陽光パネル製造装置事業につきましては、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、当期より報告セグメントから除外し、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しています。以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。

その他の売上は、上述の太陽光パネル製造装置関連の売上に加え、当社グループの物流、施設管理および保険業務などの内部サービス関連業務の売上です。当部門の外部顧客に対する売上高は、前期比49.3%増加の62億円となりました。

財政状態およびキャッシュ・フロー

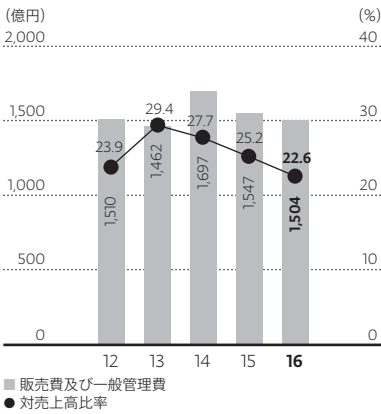
資産、負債及び純資産

■ 資産

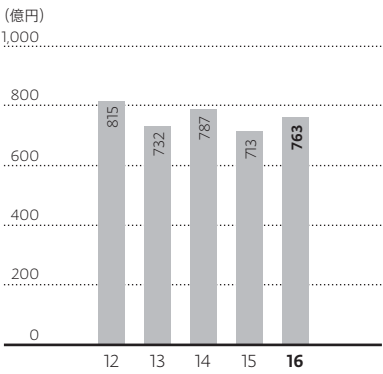
流動資産は、前期末に比べ535億円減少し6,174億円となりました。主な内容は、手元流動性(現金及び現金同等物に取得から満期日までが一年内の短期投資を加えたもの)の減少810億円、前払費用及びその他流動資産の減少12億円、たな卸資産の増加195億円、受取手形及び売掛金の増加57億円によるものです。なお、売上債権回転日数は前期の66日から64日に改善し、たな卸資産回転日数は前期の105日から107日にわずかに悪化しました。

セグメント情報	報告セグメント		百万円			
	半導体製造装置	FPD製造装置	その他	合計	調整額	連結財務諸表計上額
2016:						
売上高						
外部顧客への売上高	¥613,033	¥44,687	¥ 6,229	¥663,949	¥ —	¥663,949
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	11,592	11,592	(11,592)	—
計	613,033	44,687	17,821	675,541	(11,592)	663,949
セグメント利益	123,163	4,747	2,036	129,946	(23,479)	106,467
セグメント資産	321,100	25,186	2,134	348,420	444,948	793,368
減価償却費	8,792	424	45	9,261	9,996	19,257
のれんの償却額	970	—	—	970	—	970
減損損失	9,711	—	—	9,711	16	9,727
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,500	285	13	8,798	5,952	14,750

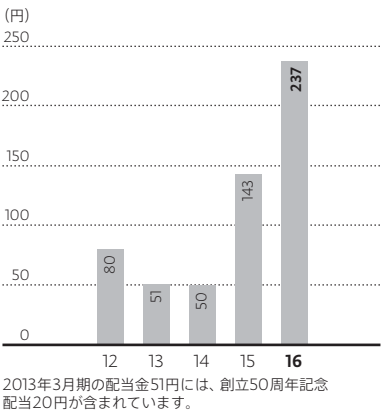
■ 販売費及び一般管理費および対売上高比率



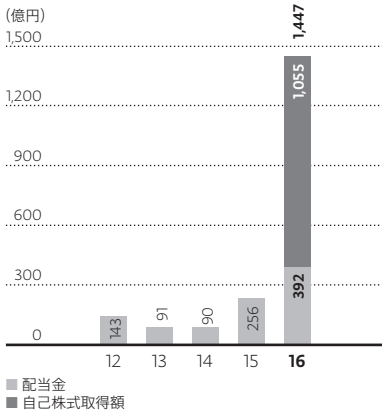
■ 研究開発費



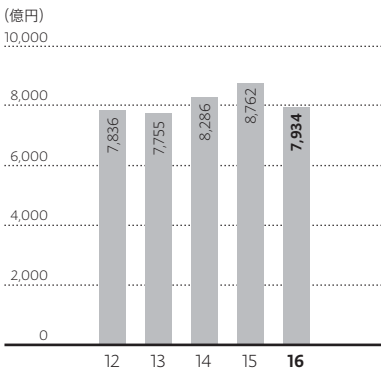
■ 一株当たり配当金



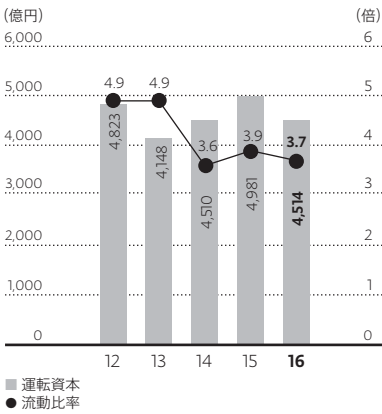
■ 株主還元総額



■ 総資産



■ 運転資本および流動比率



■ 財務概況

財務概況

有形固定資産は、新規取得分が133億円ありましたが、減価償却費193億円とTEL FSI, Inc.に係る減損などにより、純額で106億円減少の963億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から187億円減少し、796億円となりました。主な要因は、TEL FSI, Inc.の減損損失などに伴う無形固定資産の減少100億円、退職給付に係る資産の減少72億円、保有株式の売却などに伴う投資有価証券の減少40億円です。

これらの結果、総資産は前期末から828億円減少し、7,934億円となりました。

■負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ68億円減少し、1,661億円となりました。主として、前受金の減少などに伴う未払費用及びその他流動負債の減少193億円、製品保証引当金の減少18億円、支払手形及び買掛金の減少14億円によるものです。

固定負債は、退職給付に係る負債42億円が増加、その他負債33億円が減少し、前期末に比べ9億円増加し、631億円となりました。

流動負債と固定負債を合わせた負債合計は、前期末に比べ59億円減少して2,291億円となりました。

純資産は、前期末に比べ769億円減少し、5,642億円となりました。主として、親会社株主に帰属する当期純利益779億円と配当金330億円(前期末配当122億円、当期中間配当208億円)の計上などによる利益剰余金の減少612億円、退職給付に係る調整累計額の減少96億円、円高による為替換算調整勘定の減少57億円によるものです。

この結果、自己資本比率は前期から2.1ポイント低下し、70.9%となりました。また、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の11.8%から13.0%に上昇しました。

設備投資額*および減価償却費**

当期の設備投資額は、前期比1.2%増加の133億円となりました。主に、中期経営計画の達成に向け、半導体製造装置事業において、高成長が期待できる重点分野を中心にプロセス評価用機械装置、研究開発用機械装置などを取得しました。

減価償却費は、低水準の設備投資の継続により、前期比7.8%減少し193億円となりました。

* 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています
**減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません

キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比24億円減少の694億円となりました。主な内容として、税金等調整前当期純利益1,065億円、減価償却費193億円、減損損失97億円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要

因となり、たな卸資産の増加235億円、法人税等の支払額154億円、前受金の減少150億円がそれぞれキャッシュ・フローの減少要因となりました。

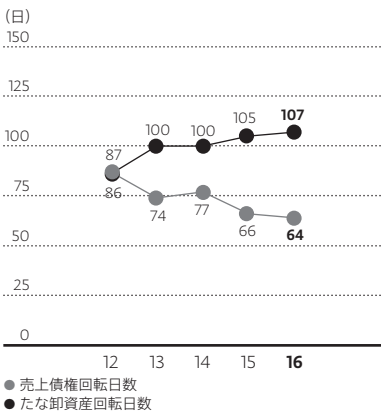
投資活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期の1,557億円の収入に対して1,500億円の支出となりました。主として、定期預金及び短期投資の純増加による支出1,410億円、有形固定資産の取得による支出113億円によるものです。

財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に、自己株式の取得による支出1,055億円、配当金の支払330億円により、前期の182億円に対し1,386億円となりました。

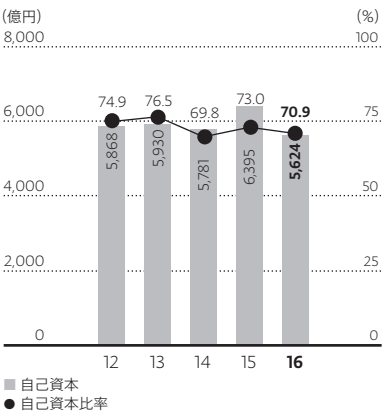
現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ2,220億円減少し、956億円となりました。なお、現金及び現金同等物に取得から満期日までが一年内の短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末に比べ810億円減少し、2,367億円となりました。

財政状態	百万円				
	2012	2013	2014	2015	2016
流動資産	¥607,051	¥521,501	¥621,492	¥670,883	¥617,416
有形固定資産	126,885	135,698	112,344	106,896	96,317
投資その他資産	49,675	118,329	94,756	98,375	79,635
総資産	783,611	775,528	828,592	876,154	793,368
流動負債	124,794	106,670	170,510	172,812	166,061
負債合計	185,008	170,401	237,978	234,991	229,129
純資産	598,603	605,127	590,614	641,163	564,239

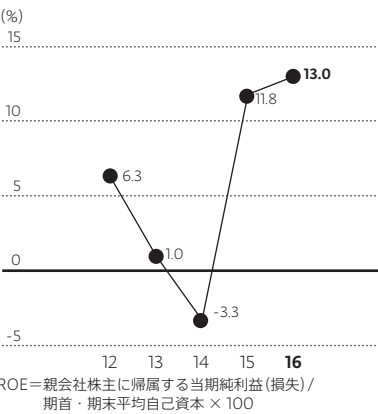
■ 売上債権回転日数および
たな卸資産回転日数



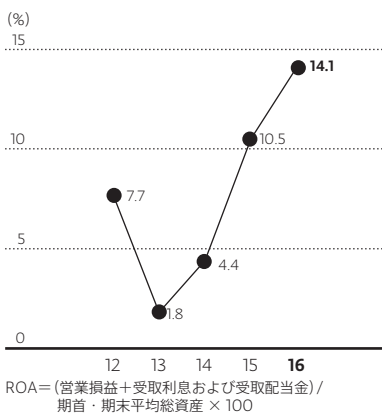
■ 自己資本および自己資本比率



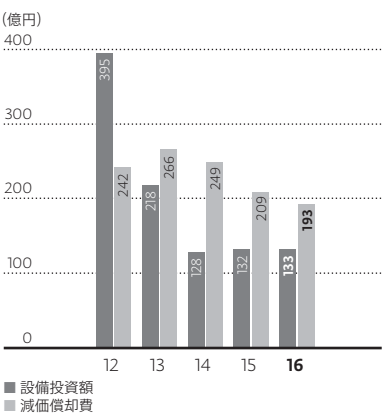
■ ROE(自己資本当期純利益率)



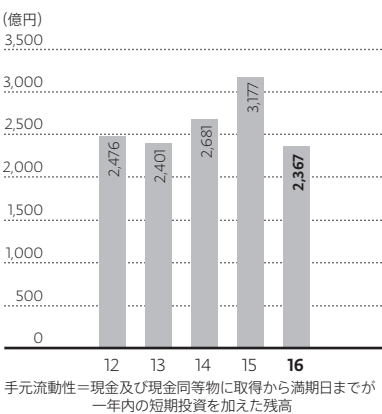
■ ROA(総資産利益率)



■ 設備投資額および減価償却費



■ 手元流動性



財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1)半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9)重要な訴訟等に関するリスク

当社は、現在においてその業績に重要な影響を与えうる訴訟等に関与しておりませんが、当社の事業活動等が今後重要な訴訟等の対象となり、その結果によっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。